

北京君正集成电路股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”、“上市公司”、“公司”)编制了截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告,具体如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2938 号)核准,公司拟通过向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金不超过 150,000.00 万元。截至 2020 年 8 月 28 日,公司实际增发人民币普通股(A 股)18,181,818 股,发行价格为人民币 82.50 元/股,募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。

前述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》,公司对募集资金实行专户存储。

(二) 前次募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 117,401.07 万元,累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 92.72 万元,募集资金账户余额合计为 32,691.65 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下:

项目	金额(人民币万元)
非公开发行股份募集配套资金	150,000.00
加:利息收入和现金管理收益扣除手续费净额	92.72
减:现金对价	115,949.00
减:面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	707.32
减:面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	744.76
期末募集资金账户余额	32,691.65

本报告中除特别说明外,所有数值保留两位小数,部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

二、前次募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,结合实际情况,公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司、北京矽成半导体有限公司(以下简称北京矽成)以及芯成半导体(上海)有限公司分别在华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司上海分行开设了募集资金存储专户,并分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求,协议的履行不存在问题。

(二) 前次募集资金存储情况

前次募集资金专项账户情况如下:

单位: 人民币元

募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行北京知春支行	10276000001067386	1,499,999,985.00	676,834.36	活期
小计		1,499,999,985.00	676,834.36	
华夏银行北京知春支行	10276000001069532		6,732,817.06	活期
华夏银行北京知春支行	10276000001083591		165,000,000.00	七天通知
小计			171,732,817.06	
南京银行股份有限公司 上海分行	0301240000004337		154,506,824.34	活期
小计			154,506,824.34	
合计		1,499,999,985.00	326,916,475.76	

三、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用前次募集资金金额 117,401.07 万元,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不适用。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异详见附表一。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2020 年 12 月 14 日,经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》([2020]京会兴专字第 01000022 号),公司以募集资金 80,000,000.00 元置换预先已使用自筹资金支付的公司重大资产重组部分现金

对价,以募集资金 6,135,503.45 元置换预先已投入募集资金投资项目“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”的自筹资金,以募集资金 6,934,137.16 元置换预先已投入“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”的自筹资金。

(五) 闲置募集资金情况说明

公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 34,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有效期为自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内。

截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金部分存放于公司募集资金专户,部分购买七天通知存款。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表二。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明

前次募集资金投资项目中支付“现金对价”不产生直接的经济效益,实施后将提高公司的综合竞争力,对公司的财务状况、经营业绩等产生积极性影响。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益 20% (含 20%) 情况说明

不适用。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

(一) 标的资产权属变更情况

公司于 2019 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2938 号),核准其发行股份购买资产并募集

配套资金事项。

2020 年 4 月 1 日,北京矽成 59.99% 股权过户至公司的工商变更登记手续办理完毕;5 月 8 日,上海承裕 100% 财产份额过户至公司及合肥君正的工商变更登记手续办理完毕,北京君正直接及间接合计持有北京矽成 100% 股权。

(二) 资产账面价值变化情况

前次发行认购资产标的公司的账面价值变化情况如下表所述

单位:人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 5 月 31 日 (合并日)
资产总额	694,269.32	707,743.99
负债总额	63,538.59	76,080.02
归属于母公司所有者权益合计	629,568.57	630,423.08

(三) 标的资产生产经营情况

单位:人民币万元

项目	2020 年 5 月 31 日 (合并日) — 2020 年 12 月 31 日
营业收入	174,381.19

北京矽成作为控股型公司,其业务主要由下属子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等主体经营,其主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟及互联芯片的研发和销售,主要产品有 SRAM、DRAM、FLASH、ANALOG 及 Connectivity 等芯片产品,产品被广泛应用于汽车电子、工业制造、通讯设备、消费电子等领域。

(四) 标的资产效益贡献情况

单位:人民币万元

项目	2020 年 5 月 31 日 (合并日) — 2020 年 12 月 31 日
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,580.43

注:标的资产效益贡献情况不包含因收购事项形成的评估增值摊销影响。

(五) 盈利预测实现情况

1、盈利预测及业绩承诺情况

根据本公司与北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)和北京华创芯原科技有限公司(以下合并简称“业绩承诺方”)签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》,业绩承诺方向本公司承诺北京矽成 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元(以下简称“承诺净利润数”)。北京矽成同期同口径盈利预测数分别为 4,859.48 万美元、6,418.42 万美元、7,903.14 万美元。

本公司和业绩承诺方确定承诺净利润数和实际净利润数应不考虑以下事项的影响:

(1) Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益;(2) 北京矽成因实施股权激励所产生的费用;(3) 北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销;(4) 配套募集资金投资项目损益。

业绩承诺期届满后,若北京矽成实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%,即视为未实现业绩承诺,则业绩承诺方将根据与本公司所签协议约定条款和条件,就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分,以股份、现金或股份与现金相结合的方式补偿。

同时,业绩承诺期届满时,本公司将聘请由各方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对北京矽成进行减值测试,如北京矽成期末减值额大于已补偿金额,业绩承诺方应根据与本公司所签协议约定条款和条件,就期末减值额与已补偿金额的差额部分,对公司以股份、现金或股份与现金相结合的方式另行补偿。

2、盈利预测及业绩承诺实现情况

单位:万美元

项目	2019年度	2020年度	2021年度
年度业绩承诺金额	4,900.00	6,400.00	7,900.00
年度业绩实现金额	4,725.37	5,586.89	
实现净利润累计数与承诺净利润累计数的差额	-174.63	-987.74	
累计业绩实现率	96.44%	91.26%	

2019-2020 年度,公司盈利预测实现率未达到 100%。

(六) 承诺事项履行情况

截至 2020 年 12 月 31 日,前次募集资金相关方均正常履行相关承诺,无违反相关承诺的行为。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

七、结论

董事会认为:

本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表一:前次募集资金使用情况对照表

附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			150,000.00			已累计使用募集资金总额：			117,401.07	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			117,401.07	
变更用途的募集资金总额比例：			0%			其中：2020 年度：			117,401.07	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	现金对价	现金对价	115,949.00	115,949.00	115,949.00	115,949.00	115,949.00	115,949.00	0.00	不适用
2	面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	16,151.00	16,151.00	707.32	16,151.00	16,151.00	707.32	-15,443.68	2025/6/30
3	面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	17,900.00	17,900.00	744.76	17,900.00	17,900.00	744.76	-17,155.24	2025/1/1
合计			150,000.00	150,000.00	117,401.07	150,000.00	150,000.00	117,401.07	-32,598.93	

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注）			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018年度	2019年度	2020年度	2018年度	2019年度	2020年度		
1	现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
2	面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
3	面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	不适用	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用

注：根据《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目的税后投资回收期约为 6.78 年，税后内部收益率约为 17.72%；面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目的税后投资回收期约为 6.9 年，税后内部收益率约为 17.68%。截至 2020 年 12 月 31 日，上述项目尚在建设期，效益实现情况尚需项目运行周期结束后测算。